

5 “条件”关联集成设计

我们针对装封箱机和喷印面要求分别给出“条件”关联现场管理子系统集成设计，主要包括关联设计、电气集成控制设计、硬件安装与机械改装设计、容错设计、硬件配置清单及配件辅材等。

5.1 YP13 “条件”关联集成方案

5.1.1 条盒 C2 面

特别说明：由于条烟 C2 面在封箱机可能出现在外侧和内侧差异，对于以上两种情况我方的固定读码器安装方案均可支持。

5.1.1.1 关联技术方案

如图所示，YP13 装封箱机条盒 C2 面二维码采集、关联技术方案硬件部分主要包含条盒 C2 面验码装置、剔除装置、条盒 C2 面二维码采集装置、条盒 C2 面二维码校验装置，存箱码采集装置和条件关联现场管理子系统。

277 / 404

